



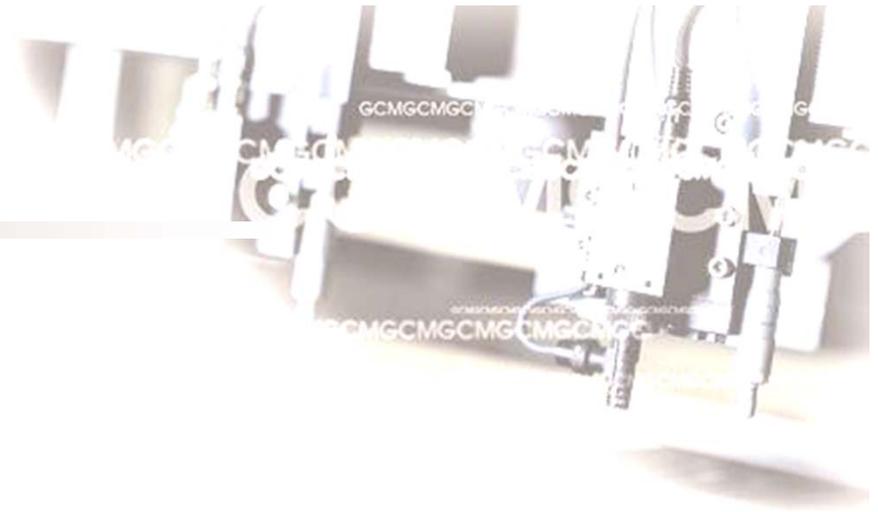
RORZE

2012年2月期決算説明会資料

2012年4月16日

RORZE CORPORATION

JASDAQ
Listed Company 6323



2012年2月期 決算概要

2012年2月期 連結損益計算書

(百万円)

	2011年2月期 実績	2012年2月期 実績	増減率	増減理由等
売上高	10,990	10,300	△6.3%	【減少要因】 ・2011年2月期に、半導体関連の設備投資が急拡大した事への反動等による、台湾子会社の受注減少 ・スマートフォンやタブレット端末など液晶関連の中小型向け設備投資が拡大した一方で、大型パネル向け投資が調整局面となった事による韓国子会社の受注減少
売上総利益	2,929	2,385	△18.6%	【減少要因】 ・台湾、韓国子会社を中心とした減収 ・新規開発を伴う装置の受注対応によるコスト増 等
販管費	1,769	1,910	7.9%	【増加要因】 ・当社単体の人件費、販売関連費用等の増加 ・開発研究資産の減価償却費増加 等
営業利益	1,159	475	△59.0%	
経常利益	1,041	527	△49.3%	(営業外損益の増減につきましては、決算短信をご参照下さい)
当期純利益	613	131	△78.6%	(特別損益の増減につきましては、決算短信をご参照下さい)

2012年2月期 連結貸借対照表

(百万円)

	2011年2月期実績	2012年2月期実績	増減額	増減理由等
流動資産	9,202	9,100	△102	・現金及び預金 +515 ・受取手形及び売掛金 △73 ・たな卸資産 △430 ・その他(未収入金) △64
固定資産等	6,368	5,962	△406	・建物及び構築物 △145 ・機械装置及び運搬具 △67 ・有形固定資産 その他(工具器具・備品) △67
資産合計	15,571	15,062	△508	
流動負債	5,588	5,258	△330	・支払手形及び買掛金 △201 ・未払法人税等 △78
固定負債	2,416	2,306	△109	・長期借入金 △133
負債合計	8,005	7,565	△440	
株主資本	7,950	8,054	103	・利益剰余金 +97
その他の包括利益累計額	△1,464	△1,705	△241	・為替換算調整勘定 △212
新株予約権	27	30	2	・新株予約権 +2
少数株主持分	1,052	1,118	66	・少数株主持分(主に韓国子会社) +66
純資産合計	7,566	7,497	△68	
負債純資産合計	15,571	15,062	△508	

2012年2月期 連結キャッシュ・フロー

(百万円)

	2011年2月期 実績	2012年2月期 実績	増減額
営業活動による キャッシュ・フロー	232	873	641
投資活動による キャッシュ・フロー	△324	△125	199
財務活動による キャッシュ・フロー	△184	△146	37
現金及び現金同等物 に係る換算差額	△69	△86	△17
現金及び現金同等物 の減少額	△345	515	860
現金及び現金同等物 の期首残高	2,262	1,917	△345
現金及び現金同等物 の期末残高	1,917	2,433	515

2012年2月期 個別損益計算書

(百万円)

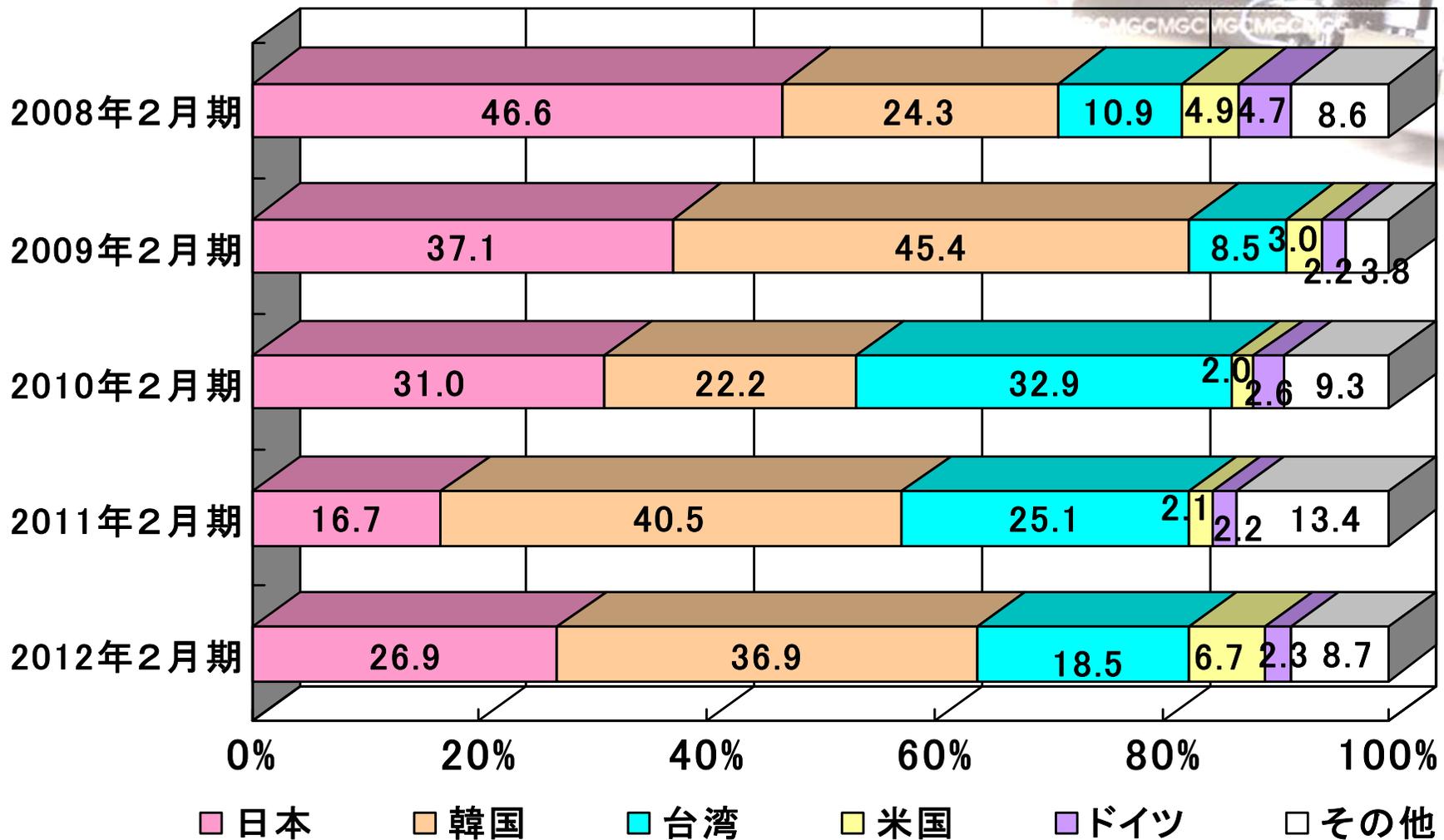
	2011年2月期 実績	2012年2月期 実績	増減率	増減理由等
売上高	4,942	5,515	11.6%	【増加要因】 ・国内向けの半導体・液晶設備投資に伴う受注増加
売上総利益	911	969	6.3%	【増加要因】 ・売上の増加 【減少要因】 ・新規開発を伴う装置の受注対応によるコスト増等
販管費	882	1,111	25.9%	【増加要因】 ・売上増加に伴う販売関連費用の他、開発関連費用の増加等
営業利益又は 営業損失(△)	29	△141	—%	【減少要因】 ・経常利益をベースとした賞与支給の為、営業外収益の大口配当金収入計上の結果、原価・販管費の人件費費用が膨らんだ事による影響等
経常利益	36	345	839.1%	(営業外損益の増減につきましては、 決算短信をご参照下さい) ・受取配当金の内、514は台湾子会社による
当期純利益	22	173	653.2%	(特別損益の増減につきましては、 決算短信をご参照下さい)

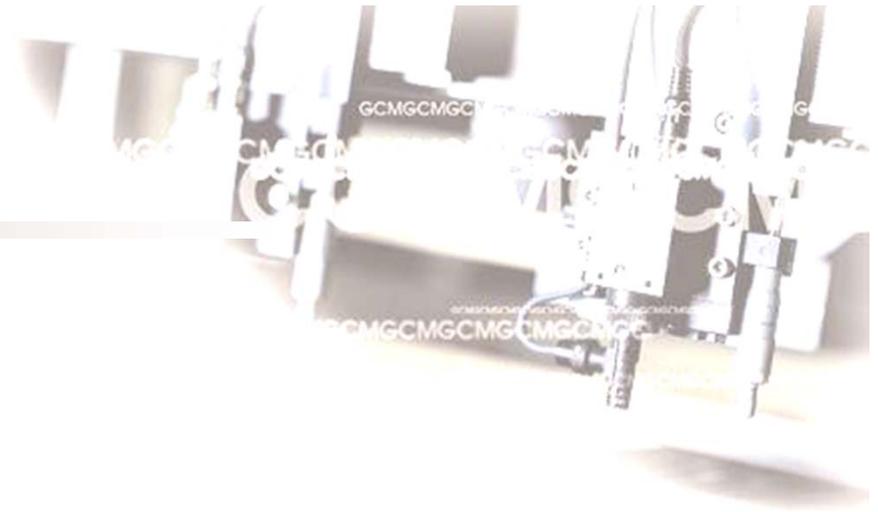
2012年2月期 個別貸借対照表

(百万円)

	2011年2月期実績	2012年2月期実績	増減額	増減理由等
流動資産	4,834	4,738	△95	・現金及び預金 +419 ・受取手形 △95 ・売掛金 +91 ・たな卸資産 △444
固定資産	8,244	8,198	△46	・建物 △67 ・工具、器具及び備品 △64 ・関係会社株式 +169
資産合計	13,079	12,937	△142	
流動負債	4,077	3,963	△113	・支払手形 △89
固定負債	2,281	2,134	△147	・長期借入金 △149
負債合計	6,359	6,098	△260	
株主資本	6,657	6,803	145	・繰越利益剰余金 +139
評価・換算差額等	34	5	△29	・その他有価証券評価差額等 △29
新株予約権	27	30	2	・新株予約権 +2
純資産合計	6,720	6,839	118	
負債純資産合計	13,079	12,937	△142	

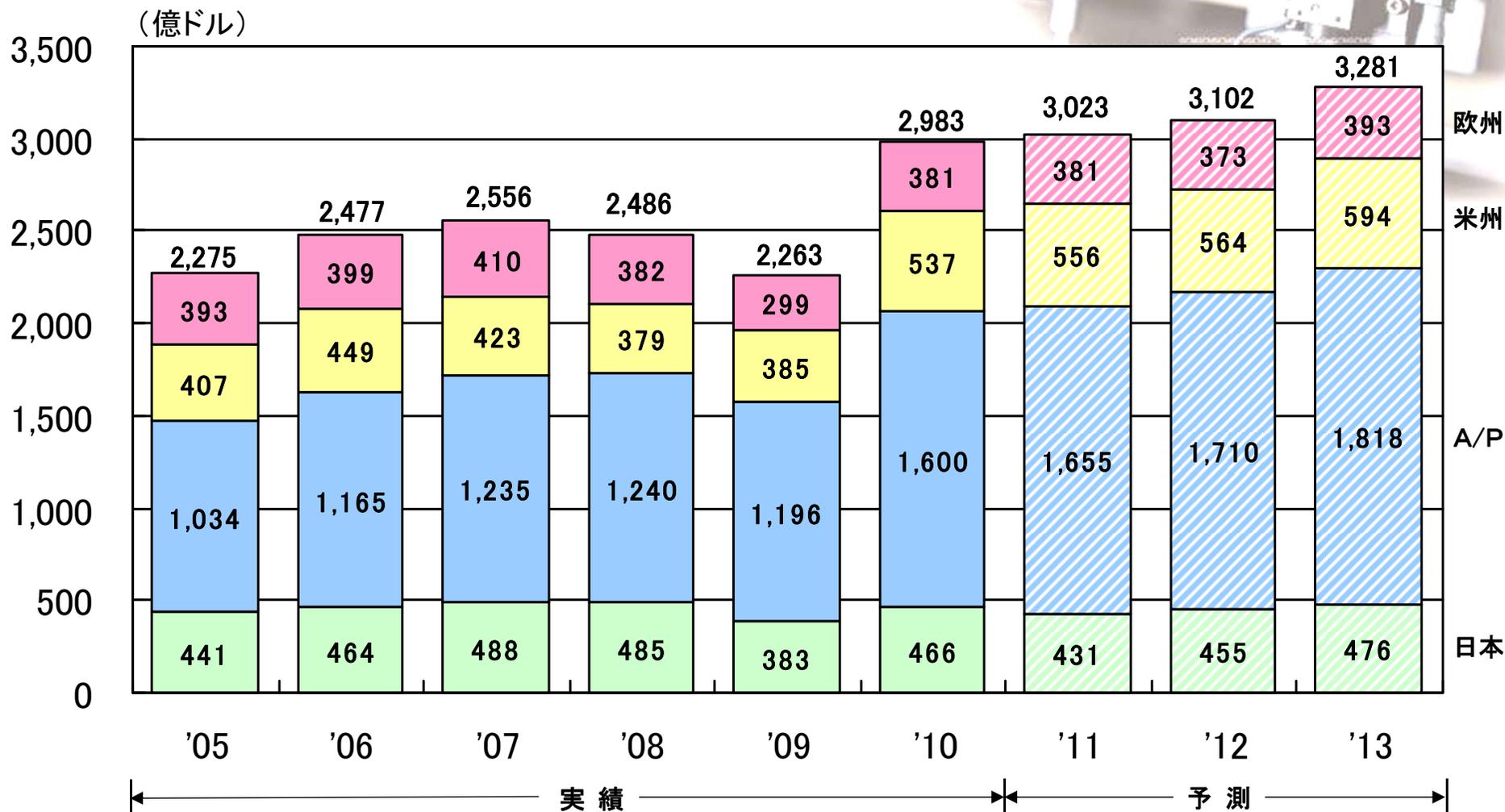
海外売上高(連結)





2013年2月期 業績予想

世界の地域別半導体市場規模

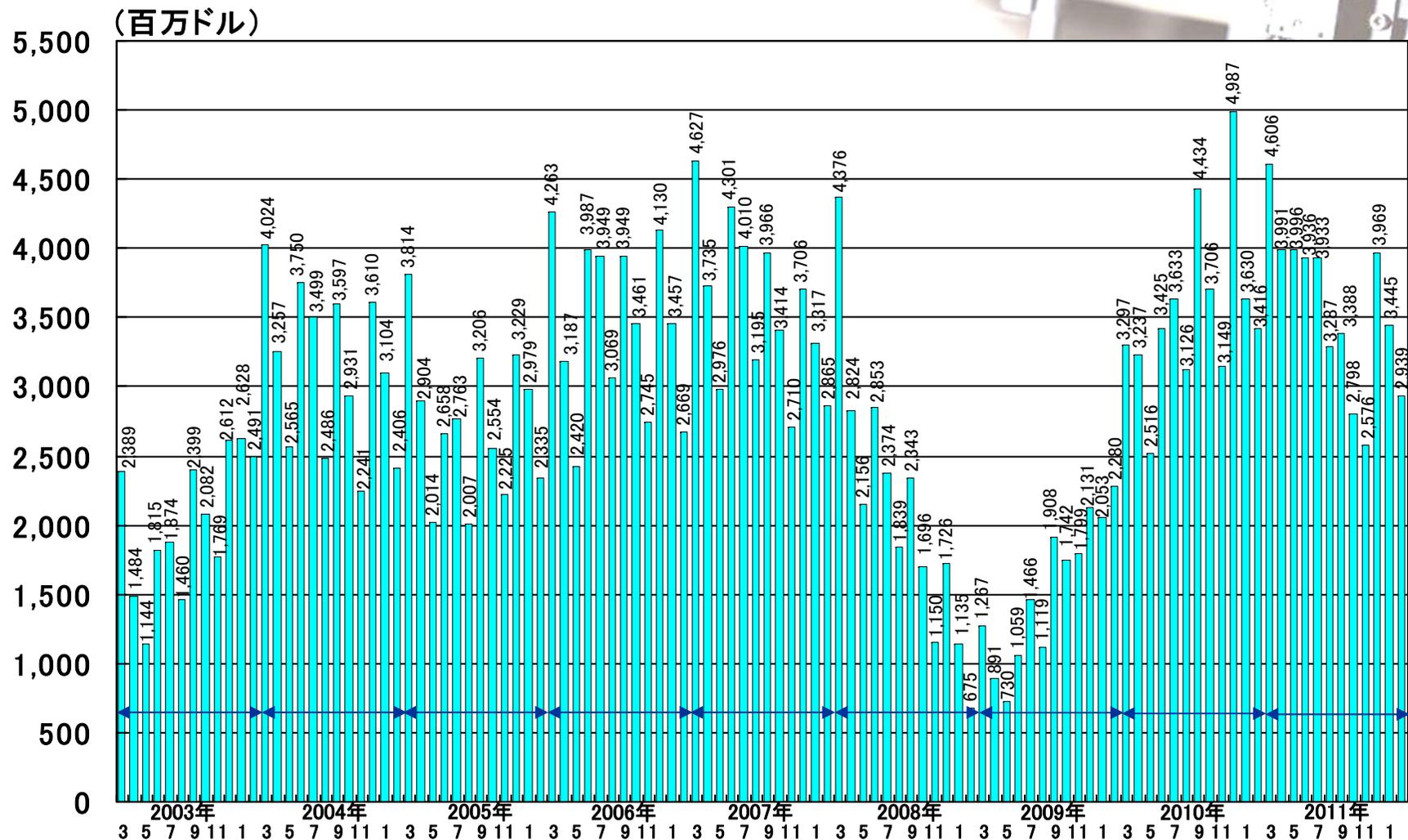


注:「A/P」はアジア・パシフィックの略

(出所:2011年12月14日付 半導体産業新聞) (2011年11月 WSTS発表)

世界規模 半導体製造装置販売統計

(2012年2月末現在)



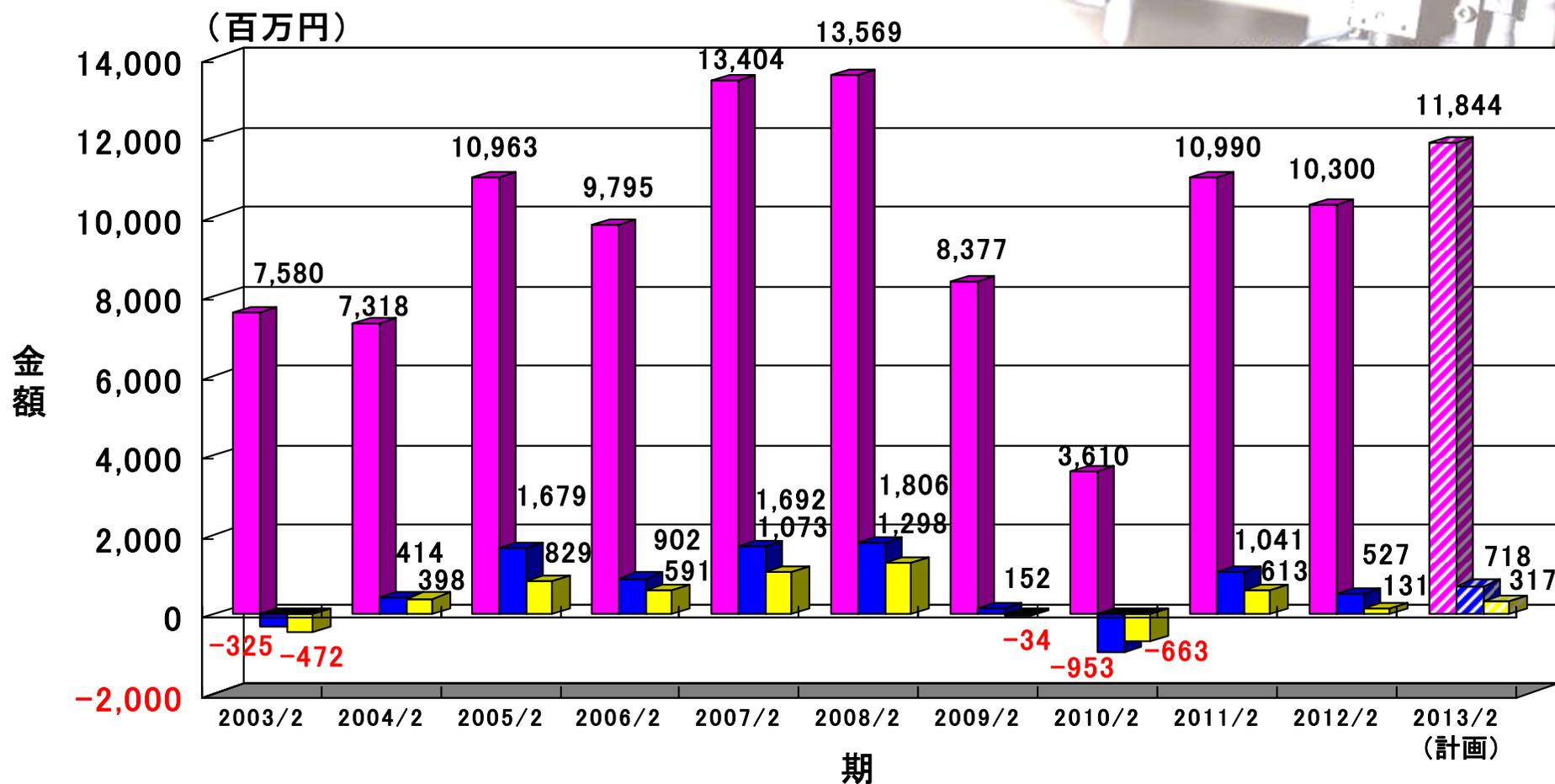
(出所：SEA J, SEMI, SEMIジャパン)

2013年2月期 連結通期業績予想

(百万円)

	2012年2月期 実績	2013年2月期 予想	増減率
売上高	10,300	11,844	15.0%
売上総利益	2,385	2,666	11.8%
販管費	1,910	1,899	△0.6%
営業利益	475	767	61.5%
経常利益	527	718	36.2%
当期純利益	131	317	141.8%

連結業績の推移と今期計画

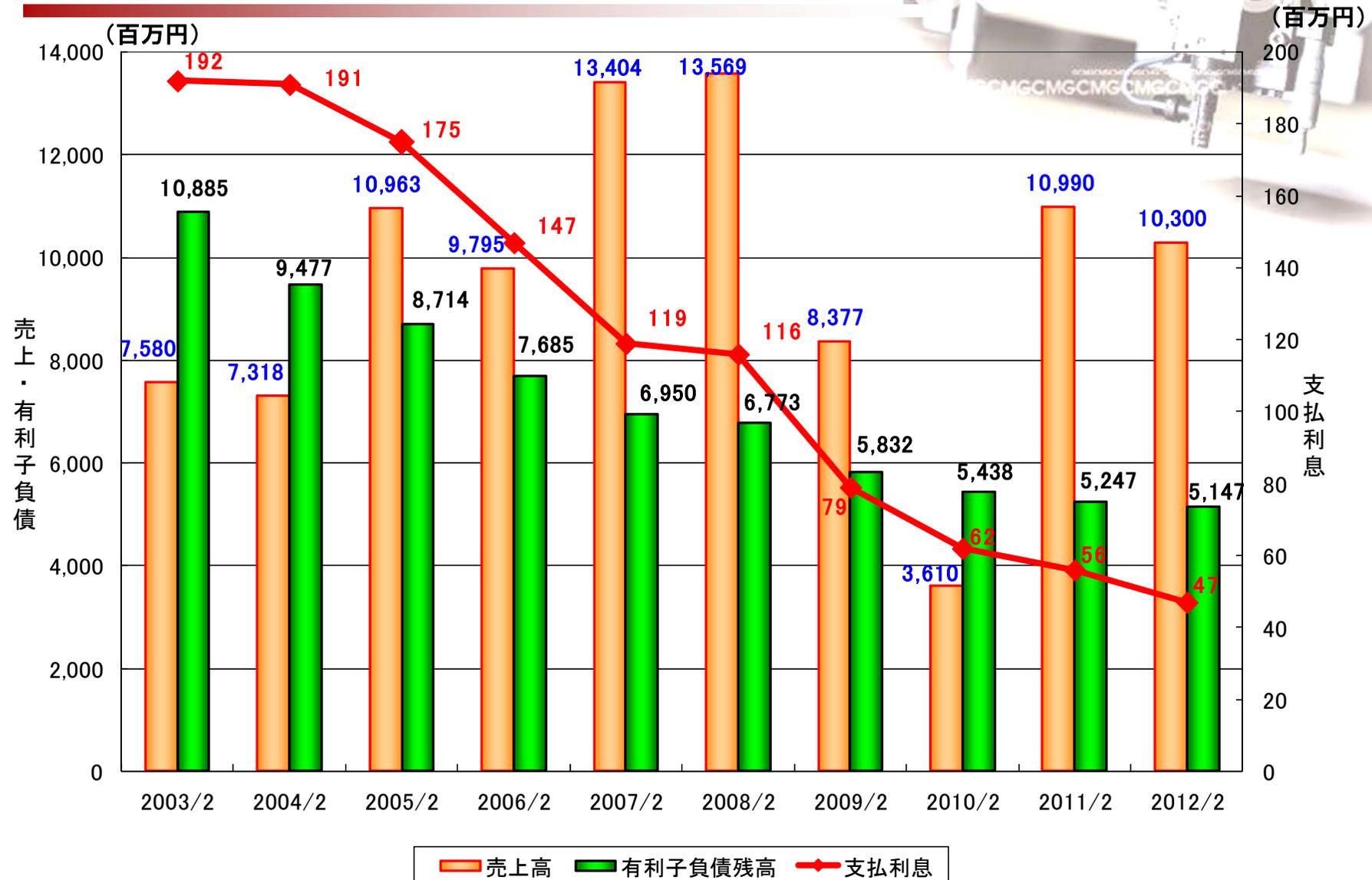


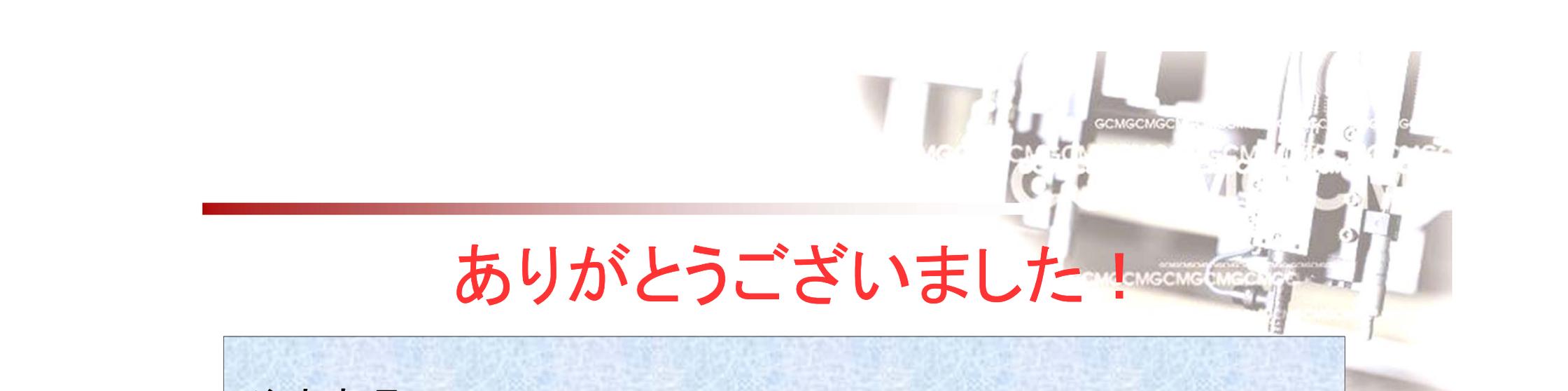
■ 売上高(実績)

■ 経常損益(実績)

■ 当期純損益(実績)

有利子負債残高の減少





ありがとうございました！

注意事項

この資料は、決算の業績に関する情報及び将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれております。

これらの記述は、当社が現時点で把握可能な情報から判断した見通しや予測であり、その情報の正確性、完全性を保証したり約束したりするものではありません。

また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり、今後予告なしに変更されることがあります。